

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

455

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

08.06.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	335		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		4
C-RS-FR4-DS-2.40mm-018+018-TG150-HF	50200872	18	L2	5
		2364		
		18	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	335		6
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		7
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		8
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	9

Dicke nach Verpressen

B00:

3090 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3410 µm

Dmin:

2770 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

3200 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3520 µm

Dmin:

2880 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

3106 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik